

平成28年3月期

第2四半期決算説明資料



株式会社 石井工作研究所  
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

<http://www.i-kkco.jp>

# 決算説明資料の構成

1. 平成 28 年 3 月期第 2 四半期決算概要
2. 平成 28 年 3 月期通期業績予想
3. 会社概要
4. セグメント別技術・新製品開発



# 1. 平成28年3月期第2四半期決算概要

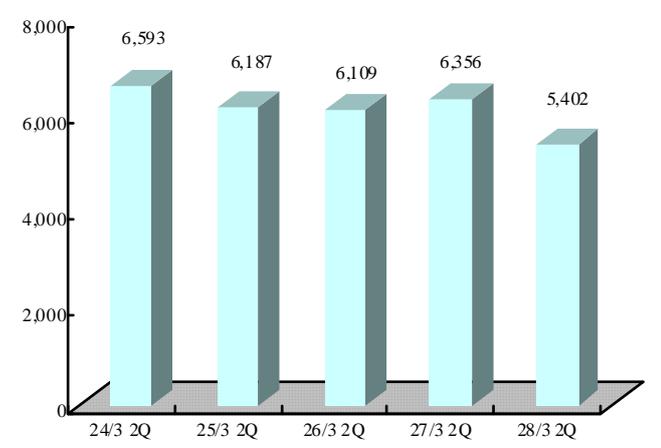
**1. 最近5年間の業績の推移**

回 次	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期	第 38 期
決 算 年 月	第2四半期	第2四半期	第2四半期	第2四半期	第2四半期
売 上 高 (千円)	1,147,867	1,116,375	1,251,282	1,558,418	1,419,148
売 上 総 利 益 (千円)	63,146	118,744	18,227	54,682	102,212
販 売 管 理 費 及 び 一 般 管 理 費 (千円)	311,045	287,874	249,977	226,972	231,576
営 業 損 失 (△) (千円)	△247,899	△169,130	△231,749	△172,289	△129,363
経 常 損 失 (△) (千円)	△224,462	△158,137	△213,303	△158,641	△124,566
四 半 期 純 損 失 (△) (千円)	△194,271	△223,767	△106,684	△188,107	△43,634
資 本 金 (千円)	1,186,300	1,186,300	1,186,300	1,186,300	1,186,300
発 行 済 株 式 総 数 (千株)	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
純 資 産 (千円)	5,561,052	5,133,359	4,891,732	4,882,788	4,466,080
総 資 産 (千円)	6,593,115	6,187,224	6,109,240	6,356,448	5,402,867
1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)	715.42	660.43	629.37	628.24	574.64
1 株 当 たり 四 半 期 純 損 失 (△) (円)	△24.99	△28.79	△13.73	△24.20	△5.61
自 己 資 本 比 率 (%)	84.3	83.0	80.1	76.8	82.7
営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ フ ロー (千円)	△187,125	38,086	2,060	△422,961	73,890
投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ フ ロー (千円)	9,066	△135,870	171,881	△4,728	50,103
財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ フ ロー (千円)	△76,947	△46,335	△46,272	370,567	△78,287
現 金 及 び 現 金 同 等 物 残 高 (千円)	1,740,949	1,289,790	1,182,487	885,028	739,180
従 業 員 数 (名)	263	256	246	243	238

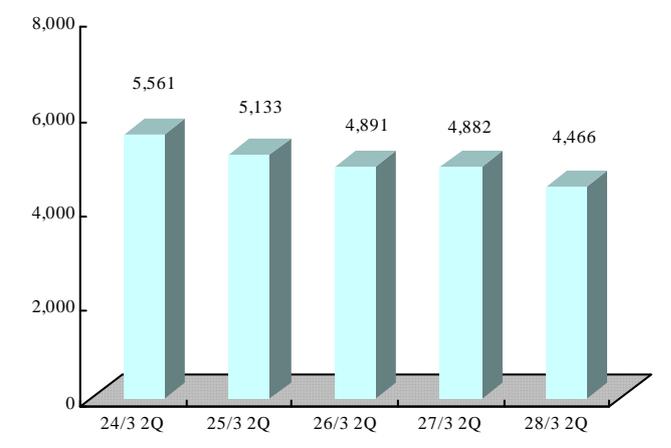


財務状態 Financial Condition

総資産 Total assets (百万円/¥Millions)

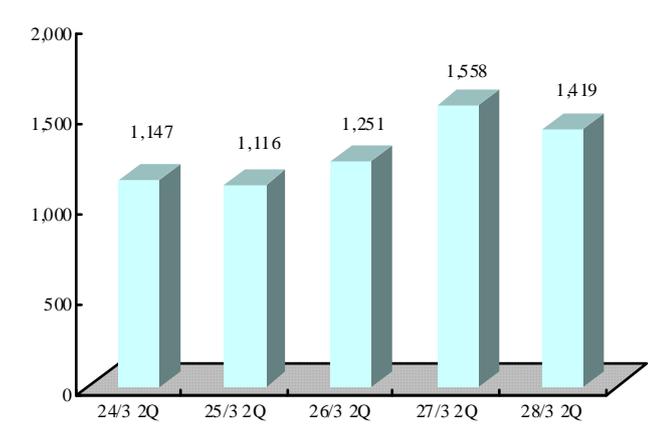


純資産 Shareholders' equity (百万円/¥Millions)

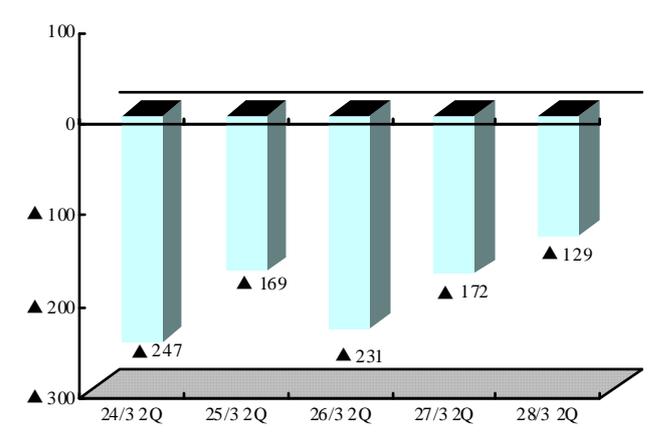


業績推移 Operating results

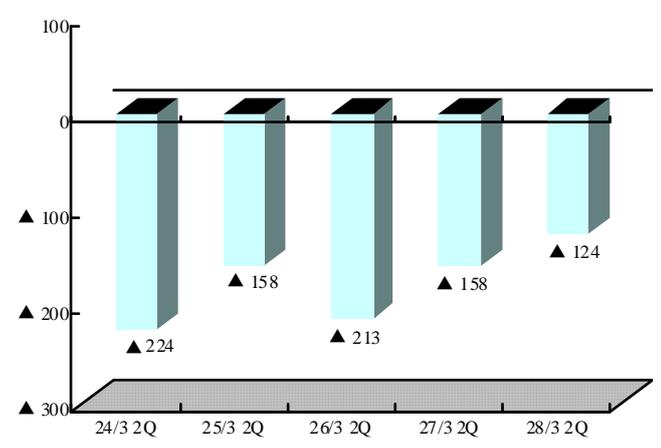
売上高 Net sales (百万円/¥Millions)



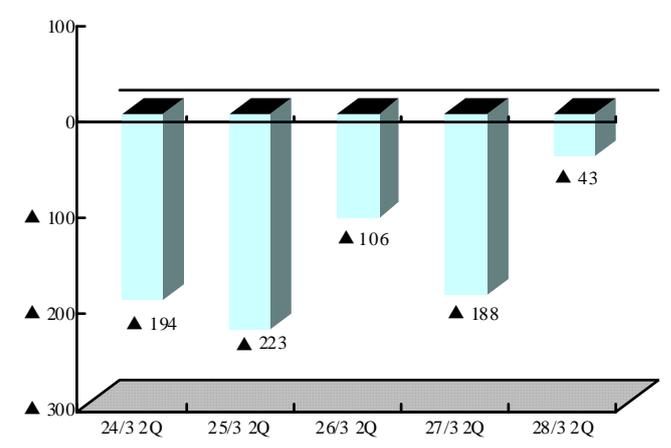
営業損失 Operating loss (百万円/¥Millions)



経常損失 Ordinary loss (百万円/¥Millions)

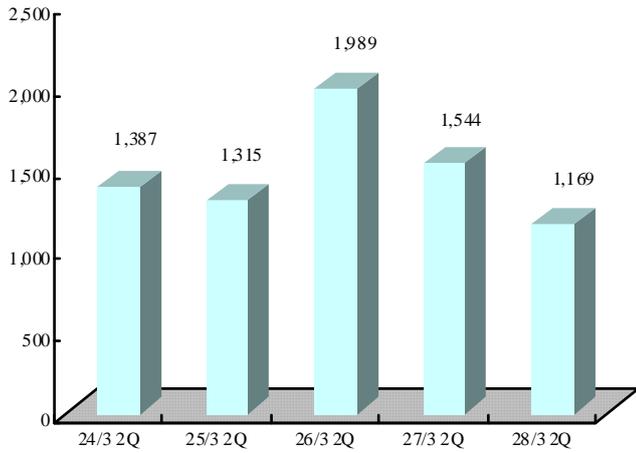


四半期純損失 Net loss (百万円/¥Millions)

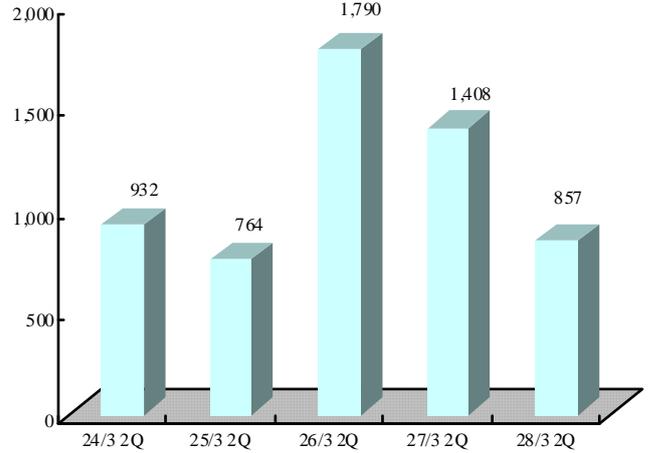




受注高 Order received (百万円/¥Millions)

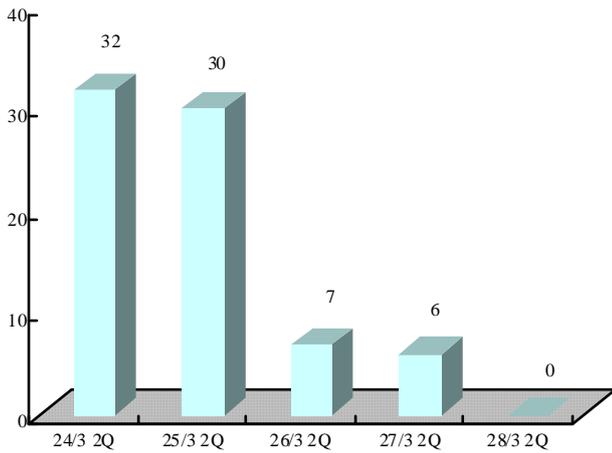


受注残高 Order backlog (百万円/¥Millions)

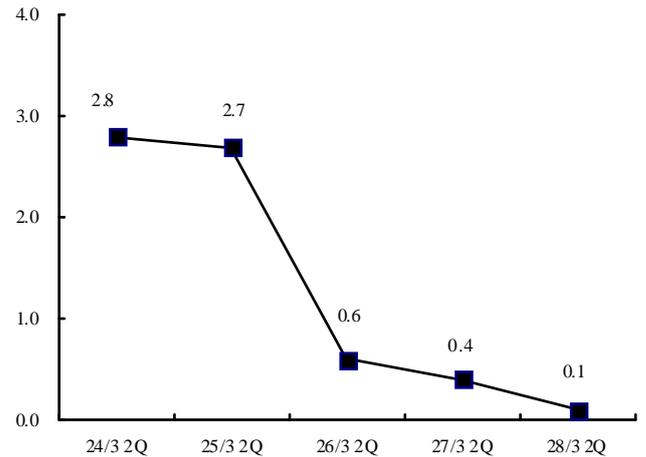


設備投資額・研究開発費等指標 Capital expenditures/Research and development expenses Data

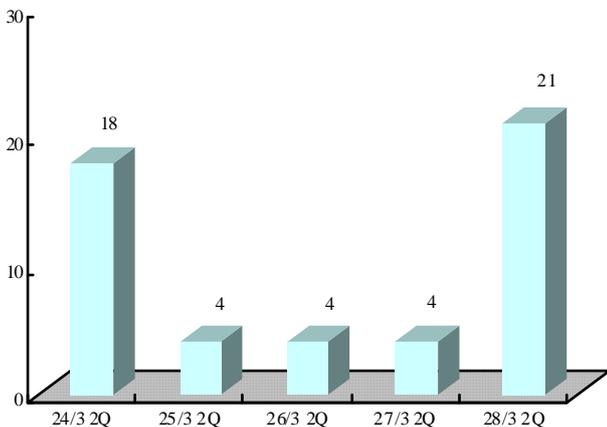
研究開発費 Research and development expenses (百万円/¥Millions)



研究開発費の対売上比率 Ratio of sales to research and development expenses (%)

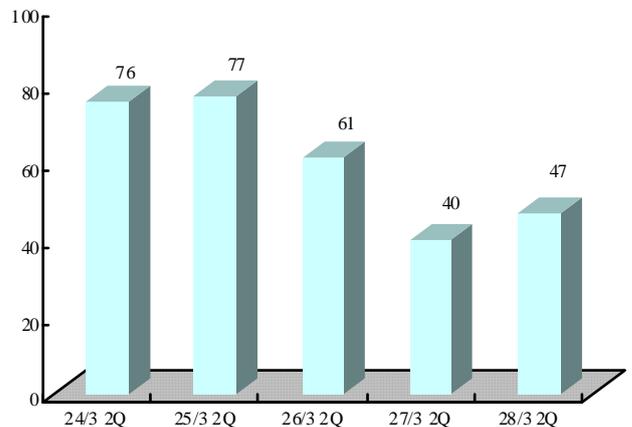


設備投資額 Capital expenditures (百万円/¥Millions)



注 リース取得価額相当額を含む

減価償却費 Depreciation (百万円/¥Millions)

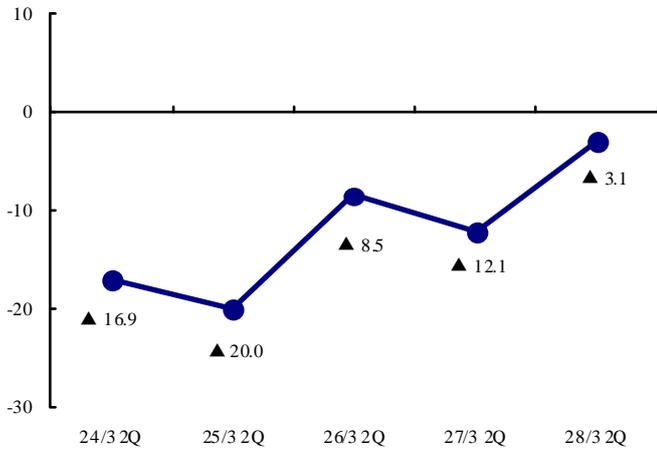


注 支払リース料における減価償却費相当額を含む

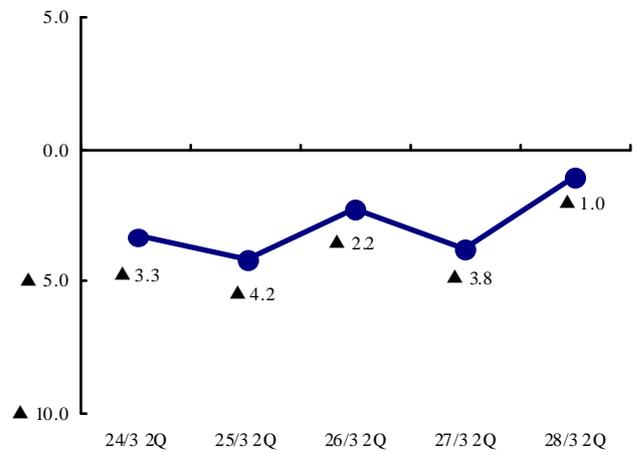


収益性指標 Profitability

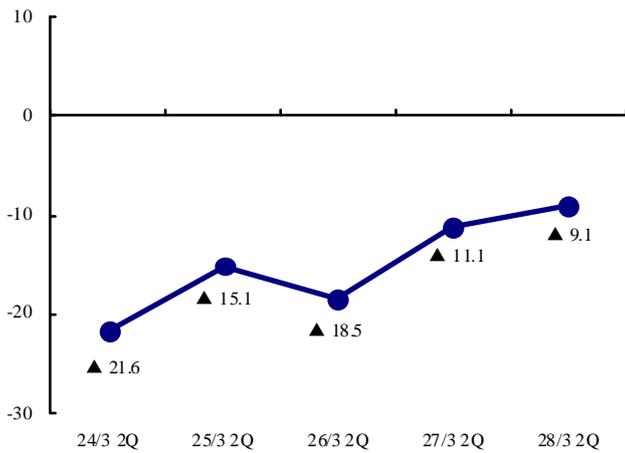
売上高純利益率 Net income to net sales (%)



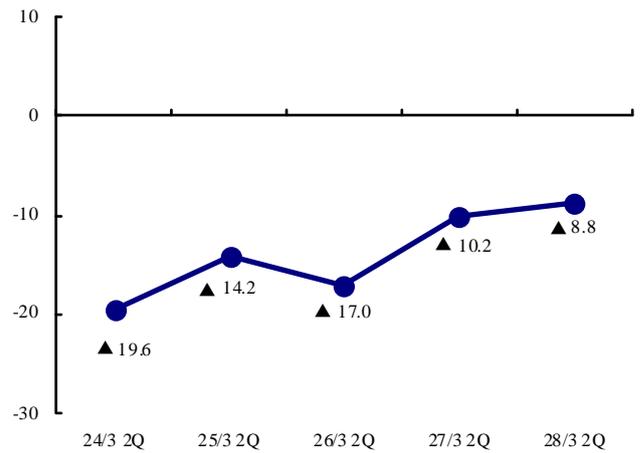
自己資本利益率 Return on equity (%)



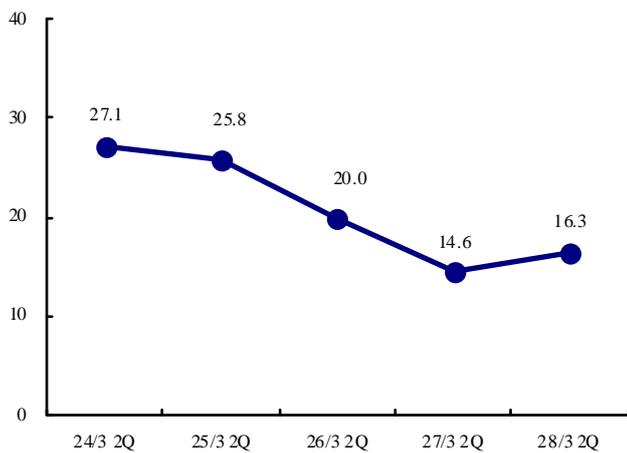
売上高営業利益率 Operating income to net sales (%)



売上高経常利益率 Ordinary income to net sales (%)



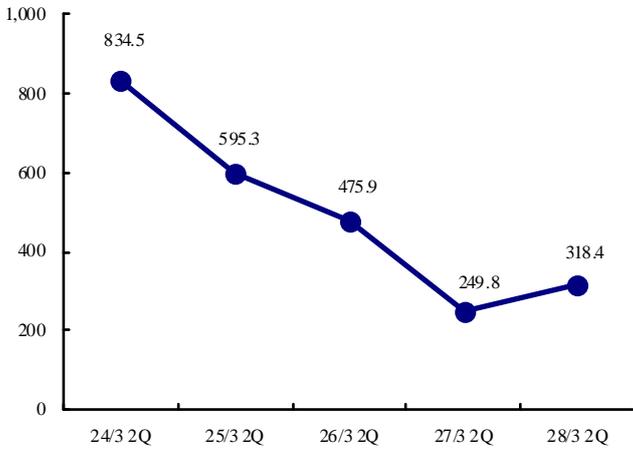
販管費の対売上比率 Ratio of sale to selling, general and administrative expenses (%)



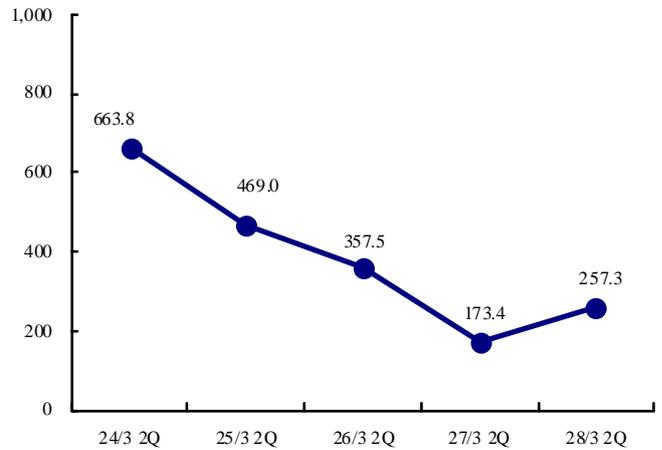


安定性指標 Financial stability

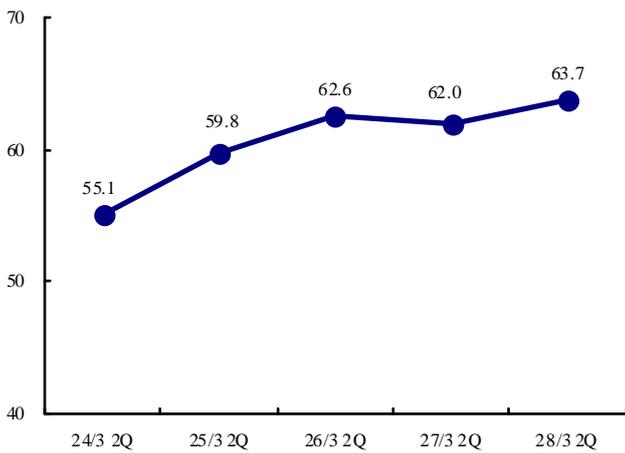
流動比率 Current ratio (%)



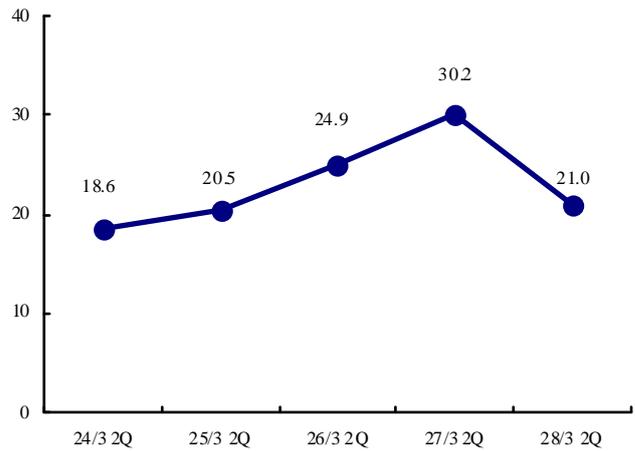
当座比率 Quick ratio (%)



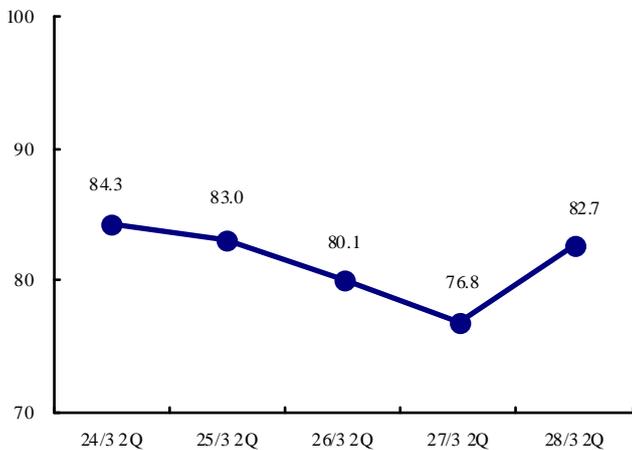
固定比率 Fixed assets ratio (%)



負債比率 Liabilities to shareholders' equity ratio (%)



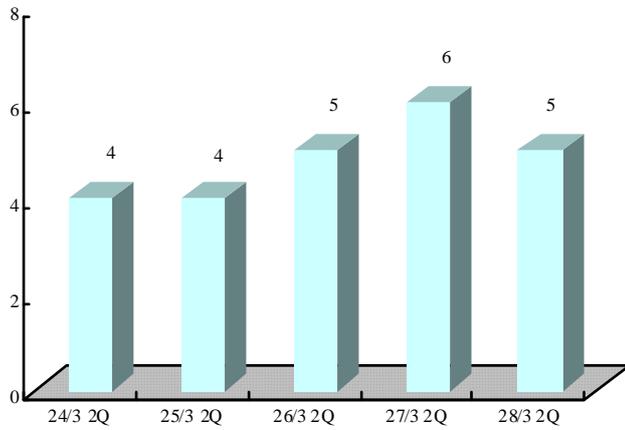
自己資本比率 Shareholders' equity to total assets (%)





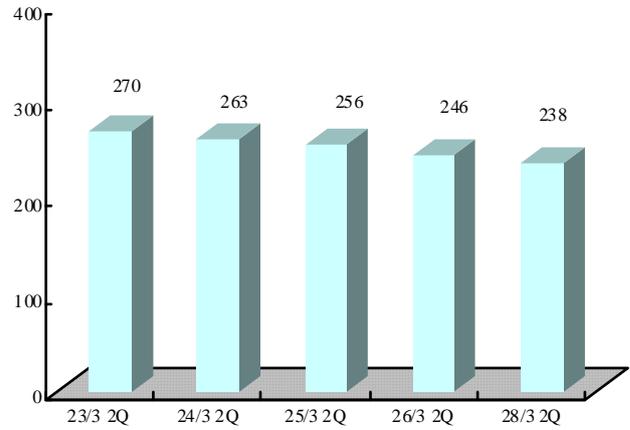
従業員 1 人当たり指標 Per employee Data

従業員 1 人当たり売上高 Net sales per employee (百万円/¥Millions)



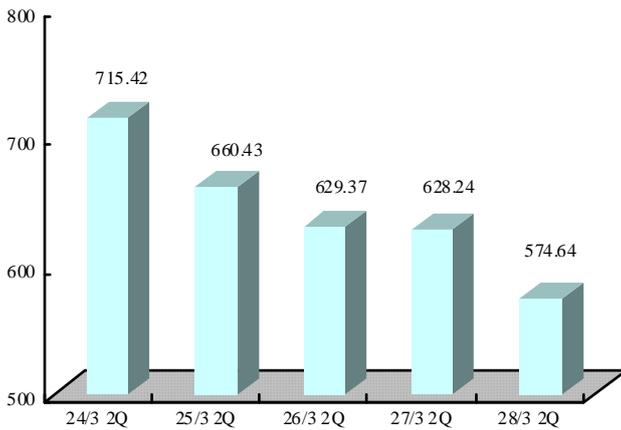
従業員数 Number of employees

(人/persons)

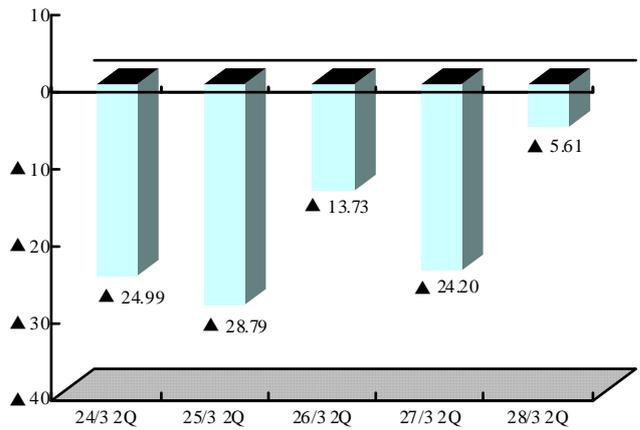


1 株当たり指標 Per share Data

1 株当たり純資産額 Shareholders' equity per share (円/¥)



1 株当たり四半期純利益 Net income per share (円/¥)



## 2. セグメント別販売実績

セグメントの名称	販売高	前年同四半期比(%)
半導体関連事業(千円)	1,414,878	93.4
不動産・建築関連事業(千円)	4,269	9.9
合計(千円)	1,419,148	91.1

(注)1. 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、当該割合が100分の10未満の場合は記載を省略しております。

相手先	前第2四半期累計期間		当第2四半期累計期間	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
第一実業(株)	573,749	36.8	552,254	38.9
三菱電機(株)	384,137	24.6	161,384	11.4

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

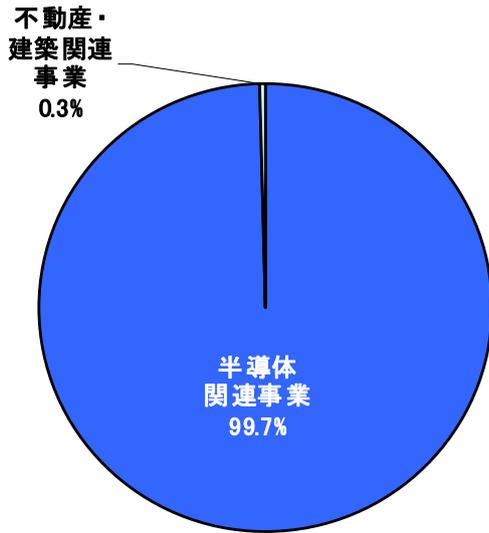
## 3. セグメント別受注状況

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同四半期比(%)	受注残高(千円)	前年同四半期比(%)
半導体関連事業	1,165,735	81.6	857,168	66.3
不動産・建築関連事業	4,157	3.6	408	0.4
合計	1,169,893	75.7	857,576	60.9

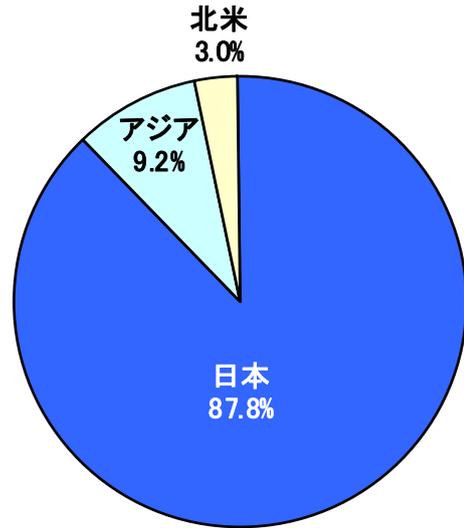
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

売上高及び受注高構成（28年3月期第2四半期）

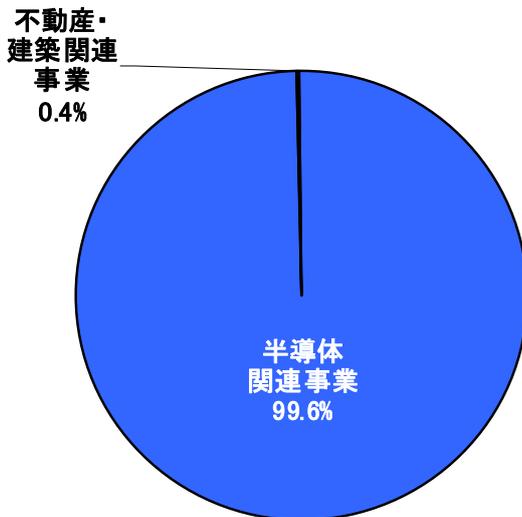
セグメント別売上高



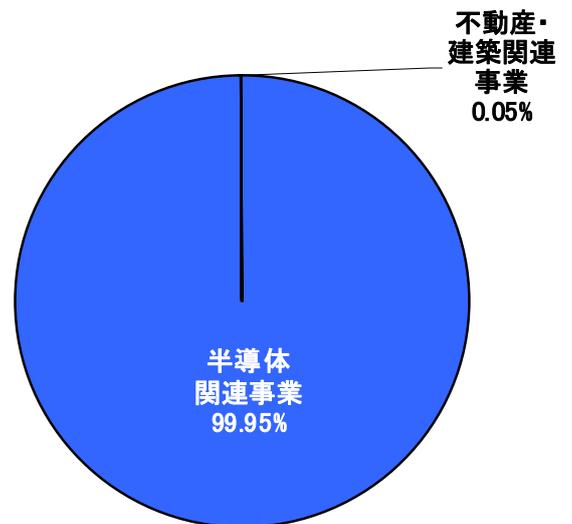
地域別売上高



セグメント別受注高



セグメント別受注残高





## 2. 平成28年3月期業績予想

**第38期(平成28年3月期)の利益計画**
**a. 利益計画表**

(単位:千円)

項目	期別		第38期予想		増減
	第37期 (27年3月期)	第38期 (28年3月期)	第37期 (27年3月期)	第38期 (28年3月期)	
売上高	3,234,302	100.0	3,300,000	100.0	65,698
売上原価	3,245,829	100.4	2,820,000	85.5	△425,829
売上総利益又は売上総損失	△11,526	△0.4	480,000	14.5	491,526
販売管理費及び一般管理費	455,461	14.1	450,000	13.6	△5,461
営業利益又は営業損失(△)	△466,988	△14.4	30,000	0.9	496,988
営業外収益	34,572	1.1	15,000	0.5	△19,572
営業外費用	4,616	0.1	5,000	0.2	384
経常利益又は経常損失(△)	△437,032	△13.5	40,000	1.2	477,032
特別利益	35,302	1.1	110,000	3.3	74,698
特別損失	85,005	2.6	—	—	△85,005
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△)	△486,735	△15.0	150,000	4.5	636,735
法人税及び住民税	5,118	0.2	6,000	0.2	882
法人税等調整額	36,613	1.1	34,000	1.0	△2,613
当期純利益又は当期純損失(△)	△528,467	△16.3	110,000	3.3	638,467

**b. 販売高のセグメント別内訳**

(単位:千円)

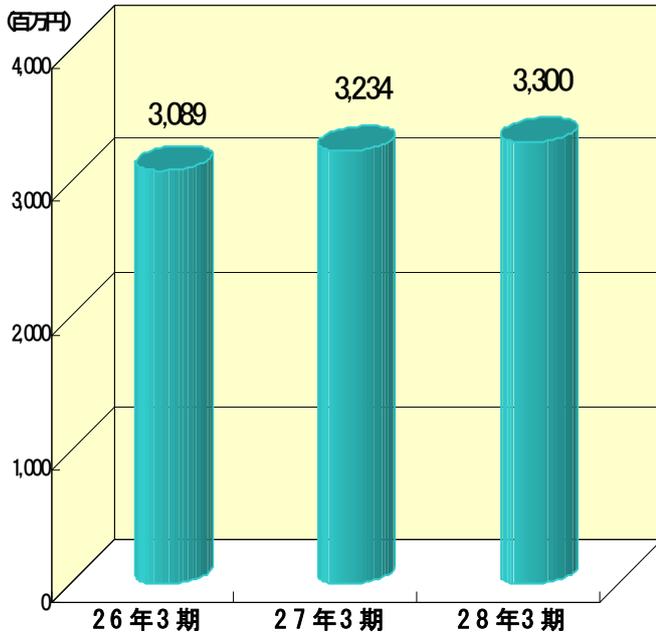
セグメントの名称	期別		増減
	第37期 (27年3月期)	第38期予想 (28年3月期)	
半導体関連事業	3,075,110	3,295,000	219,890
不動産・建築関連事業	159,192	5,000	△154,192
合計	3,234,302	3,300,000	65,698

(注)本資料に掲載されている業績予想、見通し、事業戦略につきましては、現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

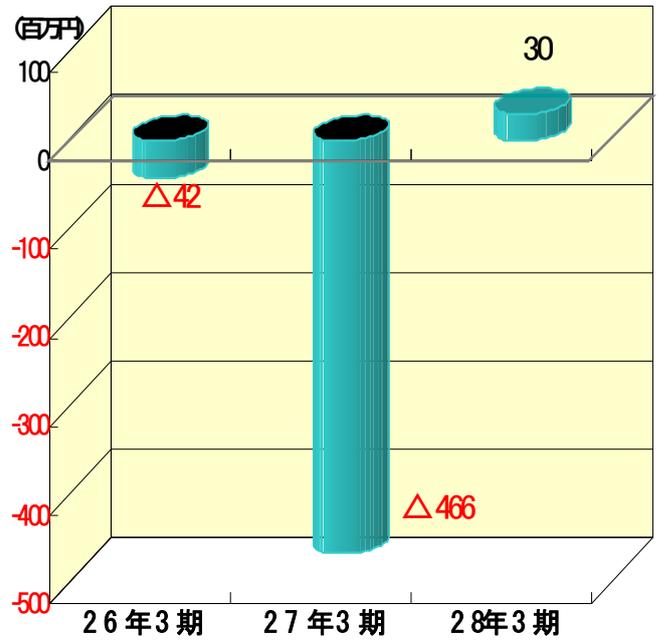


# 28年3月期の目標

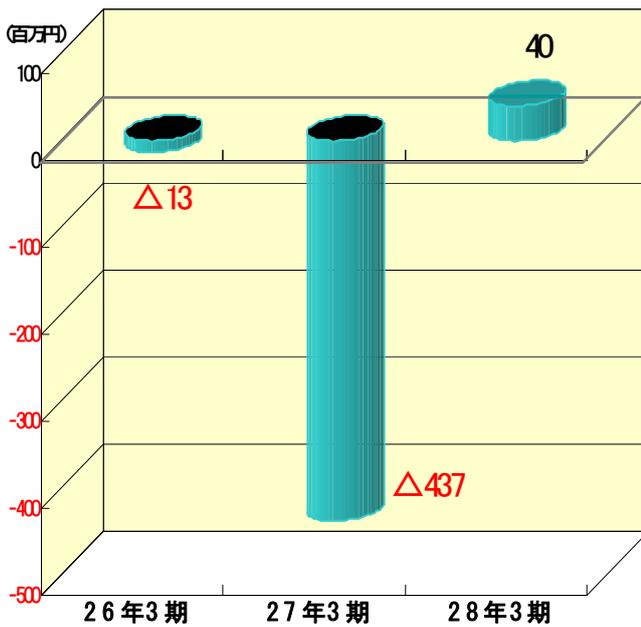
## 売上高



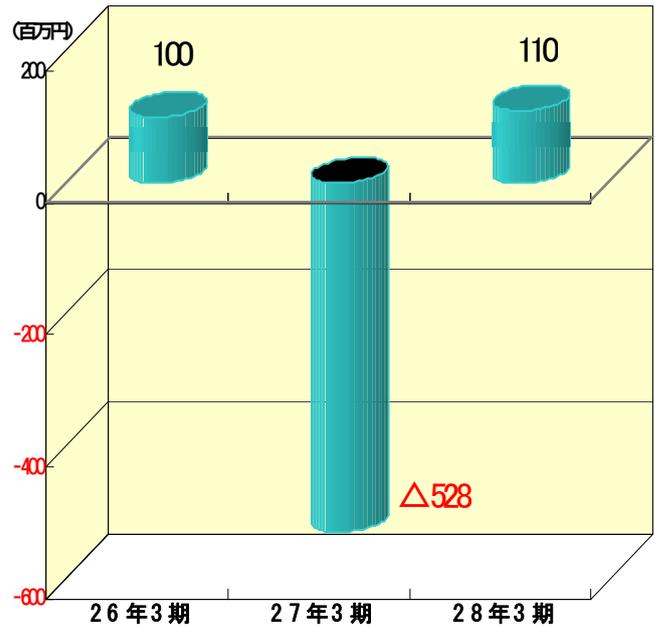
## 営業利益又は営業損失



## 経常利益又は経常損失



## 当期純利益又は当期純損失



## 3. 会社概要

# 1. 当社の経営基本方針

当社は、「たゆまず前進する技術と創意工夫によって社会に貢献する」ことを経営理念としております。そして、「正しい見識を持って意欲的に即行動し新しい価値を生む」ことを行動理念とし、「ユーザーに深く感謝する精神で早く良いものを安くに徹する」ことを経営方針として業務に取り組んでおります。

当社は、半導体製造後工程装置及び精密金型の開発、設計、製造及び販売を行う半導体関連事業を主事業とし、併せて不動産事業を展開しております。半導体関連事業においては、低騒音、省エネルギー、省スペース(小型化)をコンセプトとして切断・成形、マーキング、製品検査等を対象領域とする機器を提供しております。

2015年1月、モバイルクリエイイト株式会社(証券コード:3669)が、当社の筆頭株主及びその他の関係会社となりました。当社はこれを転機として、新たな経営体制のもと、「Change(変革)とChallenge(挑戦)」を掲げ、再出発いたします。

当社とモバイルクリエイイト株式会社、同じ大分の地で育った技術系の上場企業同士、技術者が集い、社員が活力をもって働ける環境を共に作りたい。そして、当社の持つ機械部門や電子部門の技術とモバイルクリエイイト株式会社を持つソフトウェア、クラウド、情報通信の技術を連携・融合することにより、既存ビジネスをしっかりと行いながら、事業領域の拡充とIoT(Internet of Things)分野における協力関係を構築し、企業価値向上を目指してまいります。

## 2. 会社の概要

(平成27年9月30日現在)

商 号 株式会社 石井工作研究所  
 (英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION. )  
 本 店 大分県大分市東大道二丁目5番60号  
 設立年月日 昭和54年(1979年)1月5日  
 事業内容

セグメント の名称	区 分	主 要 営 業 品 目
半 導 体 関 連 事 業	半 導 体 関 連 製 造 装 置 及 び 金 型	リード加工機 (BGA・CSP個片カット装置を含む) リード加工金型
	加 工 部 品	プラスチック成型加工品 プレス加工品、金属加工部品
	電 装 品	マイクロコンピューター、電装装置
	そ の 他	購入品、補修サービス
不動産・建築 関 連 事 業	マ ン シ ョ ン 及 び 住 宅	個人住宅・住宅用ホームエレベータ 太陽光発電装置

資 本 金 1,186,300,000 円  
 株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株  
 発行済株式総数 7,800,000株  
 1単元の株式数 100株

決 算 期 3月31日(年1回)  
 役 員 代表取締役社長 佐 藤 一 彦  
 専務取締役 中 野 雅 一  
 取締役 重 松 秀 信  
 取締役 時 枝 典 生  
 取締役 村 井 雄 司  
 取締役 岐 部 和 久  
 監査役(常勤) 衛 藤 良 一  
 監査役 姫 野 昭 雄  
 監査役 伊 東 徳

従 業 員 数 238名  
 (従業員には、臨時従業員(準社員)を含んでおりません。)

主要取引銀行 株式会社 大 分 銀 行 本 店  
 株式会社 三井住友銀行 大分支店  
 三井住友信託銀行株式会社 大分支店

**大 株 主**

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持 株 比 率
モバイルクリエイイト株式会社	2,550 千株	32.81 %
石井工作研究所 従業員持株会	896	11.53
石 井 見 紀	453	5.83
松井証券株式会社	155	1.99
石 井 光 明	150	1.93
石 井 仁 海	139	1.79
株式会社大分銀行	124	1.60
石 井 貞 憲	60	0.78
日本証券金融株式会社	58	0.75
株式会社SBI証券	57	0.74

(注) 持株比率は、自己株式(28,006株)を控除して計算しております。

### 3. 会社の沿革

年 月	概 要
昭和 54 年 1 月	(株)石井工作研究所設立(資本金 10,000 千円)。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業を開始。本社及び本社工場(旧大分工場)を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。
昭和 54 年 6 月	金属及び非金属材料販売を行なうため丸普通商(株)設立。
昭和 55 年 10 月	数値制御による機械加工を集約するため(株)大分エヌシーセンター設立。
昭和 56 年 4 月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。
昭和 56 年 5 月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に(有)石井工研産業設立(後、株式会社へ組織変更)。
昭和 58 年 12 月	丸普通商(株)を(株)九栄システム(現北九州工場)に商号変更するとともに本社を北九州市門司区に移転。
昭和 59 年 1 月	業容の拡大と合成樹脂製品製造、販売のため、大分県テクノポリス地域の指定を受けた大分県杵築市に杵築工場開設。
昭和 60 年 2 月	関西及び関東以北での販売を強化するため、大阪事務所を大阪市北区に東京事務所を東京都新宿区に開設。
昭和 61 年 3 月	半導体組立工程の5工程(①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類)を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD300」を(財)大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。
昭和 61 年 8 月	半導体製造用の低騒音、超小型のNCモータープレスの「ソフトプレス」を開発。
昭和 61 年 11 月	日本国内での販売を強化し、新製品販売促進のため東京晴海での半導体製造装置展示会“セミコン・ジャパン 86”に初めて出展。
平成 3 年 10 月	経営の合理化と経営効率を図るため、(株)大分エヌシーセンター、(株)九栄システム及び(株)石井工研産業を吸収合併。
平成 4 年 3 月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体製造の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」(協和(現りそな)中小企業振興財団・日刊工業新聞共催)を受賞。
平成 4 年 9 月	「IC検査用画像処理装置」を開発。
平成 5 年 7 月	アメリカでの世界最大の半導体製造装置展示会“セミコン・ウエスト 93”に初めて出展。
平成 5 年 9 月	本社ビル完成。
平成 7 年 4 月	大阪事務所及び東京事務所を各々営業所に名称変更。
平成 8 年 8 月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。
平成 9 年 2 月	ISO9001 認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。
平成 12 年 8 月	ISO14001 認証取得。
平成 13 年 6 月	北九州工場を北九州市小倉北区に土地・建物を取得して移転。
平成 13 年 8 月	不動産事業を開始。
平成 14 年 1 月	浄水事業を開始。
平成 15 年 11 月	大分曲工場第一期工事完成。
平成 16 年 12 月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成 17 年 12 月	大分曲工場第二期工事完成。
平成 18 年 2 月	大分工場、大分羽田工場の大分曲工場移転完了。
平成 18 年 7 月	本社所在地を大分県大分市東大道二丁目5番 60 号に住所表示変更。
平成 21 年 4 月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。
平成 21 年 6 月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。
平成 22 年 4 月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
平成 25 年 4 月	閉鎖していた北九州工場を売却。
平成 25 年 7 月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)に上場。
平成 26 年 5 月	当社創業者石井見敏氏逝去。
平成 27 年 5 月	大分羽田工場を売却。
平成 27 年 10 月	熊本営業所を閉鎖。
平成 27 年 10 月	東京営業所を移転。



## 4. 営業所及び工場

- ① 本 社                    大分県大分市東大道二丁目5番60号
- ② 営 業 所  
    東京営業所            東京都港区
- ③ 工 場  
    大分曲工場            大分県大分市  
    杵築工場              大分県杵築市



# 4. 技術・新製品開発

# オフィスが半導体工場に

## ミニマルから始まる日本の先進技術

ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION

超小型生産システムの開発構想から生まれたミニマルファブ  
 革命的な超小型半導体製造装置により多品種少量生産に適した生産システム

### 生産工程 Process Start▼

ミニマル生産ラインのダイボンダ、インクジェットプリンターの開発を行っています。

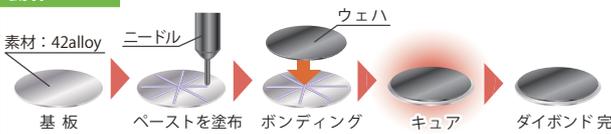
#### ダイボンダ

### Die Bonder

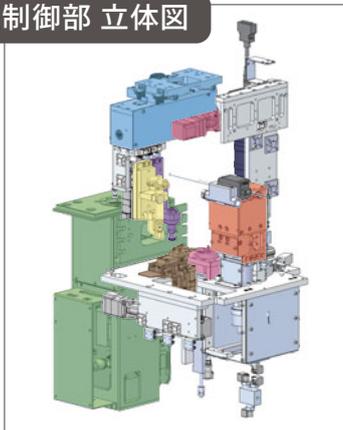
ミニマルダイボンダ

ミニマルサイズを実現した超コンパクトダイボンダ  
 ・リニアモータ制御によりボンディング機構の小型化と加圧制御の容易化を実現しました。

#### 動作フロー



#### 加圧制御部 立体図



DBミニマル装置写真



モールド樹脂成形

レーザービア

デスピア

Cu シード層

Cu メッキ

レジスト塗布

マスクレス露光

現象

Cu エッチング

レジスト除去

インクジェットプリンター

はんだボール搭載

はんだリフロー

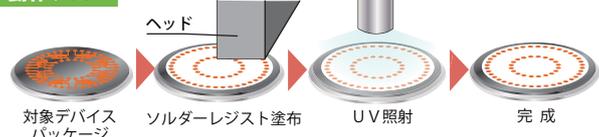
Finish

### Ink Jet Printer

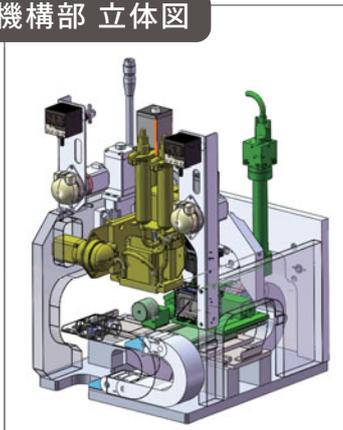
ミニマルインクジェットプリンター

ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜  
 ・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜させる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ規格のコンパクトな筐体に納めました。

#### 動作フロー



#### IJP 機構部 立体図



IJPミニマル装置写真



本資料に関するお問い合わせ



**株式会社 石井工作研究所**  
**ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.**

**IR担当者 時枝**

TEL :097-544-1001

E-mail : [tokieda@i-kk.co.jp](mailto:tokieda@i-kk.co.jp)